泰國簽署半導體合作備忘錄，加速打造區域技術研發基地

駐泰國代表處教育組

2025 年 11 月 14 日，泰國高等教育、科學、研究與創新部（MHESI）舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由高教部常務次長素帕才教授博士（Prof. Dr. Supachai Pathumnakul）主持。簽署單位包括高教部辦公室、泰國半導體產業協會（THSIA）、國家研究辦公室，以及全國 19 所合作大學，地點為泰國北曼谷國王科技大學。

北曼谷國王科技大學受高教部指派，擔任泰國半導體與印刷電路板（PCB）人才培訓中心，旨在強化泰國半導體產業的生態系統，並透過泰國半導體產業協會作為橋樑，整合學術界與產業界的合作，包括學術、研究與技術轉移等領域。

此次合作旨在全面推動微電子與半導體領域的學術與研究發展，涵蓋從電路設計、IC 組裝到電性測試等完整產業鏈。同時將培育具備高技能之半導體人才，包含學位課程與短期課程，以因應快速成長的產業需求，並推動泰國成為區域級半導體技術生產與研發基地。

參與簽署的 19 所大學皆為泰國領先高校，包括先皇技術大學（拉卡邦）、朱拉隆功大學、卡塞薩特大學、瑪希敦大學、孔敬大學、清邁大學、法政大學等全國知名大學與技術學院。

撰稿人/譯稿人：駐泰國代表處教育組

資料來源：2025 年 11 月 18 日，泰國高等教育、科學研究與創新部 （MHESI）
https://www.mhesi.go.th/index.php/news-and-announce-all/news-all/executive-ps-news/12080-